



半导体行业点评：数字化转型 持续推进 WIFI 6 芯片市场导 入提速



核心要点:

WI-FI 和 5G 作为物联融合的重要联接技术，在万物互联时代，互为补充数字化转型的成功以信息传输、物联融合为基础；5G 蜂窝网络囿于设备承载量有限且部署成本较高，通常用于室外广域数据传输。WI-FI 相较于 5G 蜂窝网络具有部署便捷、灵活性强、成本优势显著（每比特成本约为蜂窝网络的 1/30）、兼容性强等特性，成为室内数据传输和室外短距离传输的主力技术，与 5G 移动通信互为补充。

WI-FI 具有较高的商业价值，下游需求助推 WI-FI6 芯片市场渗透率快速提升

数字化时代 WI-FI 的出货量及对经济的促进效用与日俱增，WI-FI 联盟数据显示，2021 年度 WI-FI 带动的全球经济价值或超过 3 万亿美元，预计到 2025 年将增加至 4.9 万亿美元。

应用场景的不断扩展带动数据量及传输量的高速增长，WI-FI 设备的数据传输效率、设备接入量、安全性等技术指标的优化成为驱动需求端进行产品迭代的重要因素。WI-FI6 最大速率为 9.6Gbps，时延最低可缩短至 10ms 左右，AP（无线访问节点）容量是 WI-FI5 的 4 倍，终端功耗节约 30%以上；可满足智能家居、智慧教育、园区智慧办公及智能制造，VR/AR 等对带宽和时延和安全性的使用要求，市场竞争力强劲。

WI-FI 联盟数据显示，2019 年度 WI-FI6 系列芯片出货量占总出货量

比例约为 10%，2021 年度全球 WI-FI6 系列芯片出货量占比近 60%，华为预测 2023 年 WI-FI6 系列芯片出货量占比或提升至 90%。ResearchandMarket 预计全球 Wi-Fi6 芯片 2021 年市场规模为 34 亿美元，2026 年将增长至 91 亿美元。

投资建议

数据高效安全传输，低时延及支持多设备接入为实现万物互联的基础；WI-FI6 系列芯片性能优势显著，适配于设备连接数量持续增多的下一代物联网连接场景。中长期受益于产业数字化转型持续推进及物联网终端连接量快速上行，WI-FI6 系列芯片受益市场渗透率及出货量预计持续上行。建议持续关注集成电路设计板块及半导体制造板块，维持行业增持评级。

风险提示

市场渗透率提升不及预期；研发进展不及预期；内外部宏观政策变动。

关键词：5G AD 智能家居 物联网 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36826

